PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-027810

(43)Date of publication of application: 30.01.2001

(51)Int.Cl.

G03F 7/11 C08F220/12 C08F220/58 C08L 33/04 C08L 33/26 G03F 7/027 H01L 21/027

(21)Application number: 11-149872

(22)Date of filing : 28.05.1999

(71)Applicant : JSR CORP

(72)Inventor: KAWAGUCHI KAZUO

SAITO AKIO IWANAGA SHINICHIRO

(30)Priority

Priority number : 10165880 11129150

Priority date : 29.05.1998 10.05.1999 Priority country: JP

(54) FORMATION OF ACRYLIC COPOLYMER, ANTIREFLECTION FILM FORMING COMPOSITION CONTAINING IT AND RESIST FILM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To form a resist pattern which has high antireflection effect, generates no intermixing, has high etching speed and is excellent in resolution, precision, etc., by incorporating a copolymer having two kinds of specific structure units and a solvent into a composition.

SOLUTION: An antireflection film forming composition contains the copolymer having a structure unit expressed by formula II and the solvent. In formula, R1 denotes hydrogen atom, halogen atom, 18C hydrocarbon group or the like and when plural R1 are present, they may be the same or different. R2 denotes hydrogen atom or methyl group and (m) denotes 1 to 9 integer. In formula II, R3 denotes hydrogen atom or methyl group and R4 denotes hydrogen atom or or granic group. The copolymer contains the structural unit of formula II by 5 to 90 mole % and the structural unit of formula II by 5 to 80 mole % on the basis of total of the structural units expressed by the formula 1 and formula II and other structural units drived from unsaturated monomers.

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-27810 (43)公開日 平成13年1月30日(2001.1.30)

(P2001-27810A)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコート*(参考)
G03F 7/11	503	G03F 7/11	503 2H025
C 0 8 F 220/12		C 0 8 F 220/12	4 J 0 0 2
220/58		220/58	4 J 1 0 0
CO8L 33/04		C 0 8 L 33/04	5 F 0 4 6
33/26		33/26	

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全12頁) 最終頁に続く

(21) 出職番号 特面平11-149872

(22)出顧日 平成11年5月28日(1999.5.28)

(31) 優先権主張番号 特顯平10-165880

(32) 優先日 平成10年5月29日(1998.5.29)

(33)優先權主張国 日本 (JP) (31) 優先権主張番号 特職平11-129150

(32) 優先日

平成11年5月10日(1999.5.10)

(33)優先権主張国 日本 (JP)

(71) 出版人 000004178

ジェイエスアール株式会社

東京都中央区築地2丁目11番24号 エスアール株式会社内

(72)発明者 河口 和麓

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

(72)発明者 齋藤 明夫

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内 (74)代理人 100084308

弁理士 岩見谷 周志

最終質に続く

(54) 【発明の名無】 アクリル系共重合体およびそれを含有する反射防止膜形成組成物並びにレジスト膜の形成方法

(57) 【要約】

【課題】反射防止膜は反射防止効果が高く、レジスト膜 とインターミキシングを生じることがなく、エッチング 速度が高く、解像度及び精度等に優れたレジストパター ンを形成しうる反射防止膜形成組成物を提供する。 【解決手段】一般式(1)で示される機造単位および下 記一般式(2)で示される構造単位を有する共重合体、 該共重合体と溶剤とを含有する反射防止膜形成組成物。 [ft 1]

(式中、R,は水素原子、ハロゲン原子または炭素原子 数1~6の炭化水素基など、R,は、水素原子またはメ チル基を示し、mは1~9の整数を示す。) 【化2】

(式中、R,は、水素原子またはメチル基を示し、R 』は、水素原子または有機基を示す。)

1

[特許請求の範囲]

【請求項1】 下記一般式(1)で示される構造単位および下記一般式(2)で示される構造単位を有する共重合体:

【化1】

$$\begin{array}{c} R_2 \\ C - CH_2 \\ CO \\ O \\ CH_2 \end{array} \tag{1}$$

(式中、R,は水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数1 ~6の炭化水素基、ニトロ基、第1版アン基、ヒトロ 中込基、アシル基、カルボキシル基、スルホン基また はメルカブト基を示し、R,が複数存在する場合にはそ れらは間一でも異なってもよく、R,は、水素原子また はメルカブト基を示し、mは1~9の整数を示す。) 【化2】

(式中、R₃は、水素原子またはメチル基を示し、R 」は、水素原子または有機基を示す。)。

[請求項2] 請求項1の共重合体であって、分子中に 含まれる全構造単位か合計を基準にして、一般式(1) の構造単位が5~90モル%存在し、一般式(2)の構 造単位は、5~80モル%存在する、共重合体。

【請求項3】 請求項1に記載の共重合体と、溶剤とを 含有することを特徴とする反射防止膜形成組成物。

【講楽項4】 1) 基板上に請求項3に記載の反射物上 順形成朝成物を塗布し、しかる後ペークして反射防止膜 を形成する工程、2) 該反射防止膜上にレジス・組成か を塗布し、しかる後ペークしてレジスト膜を形成する工程 程、3) 盆レジスト膜に電影用マスクを介して放射 開射する工程、4) 放射線を削射したレジスト膜を現像 する工程、及び5) 反射防止膜をエッチングする工程を さな、パターン化したレジスト膜の形成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、新規なアクリル系 共重合体およびそれを含有する、各種の放射線を用いる リソグラフィープロセスにおける微細加工に有用で、特 に集積回路素子の製造に好適な反射防止膜形成組成物に 関する。

[0002]

【従来の技術】集積回路素子の製造方法においては、より高い集積度を得るために、リソグラフィーブロセスにおける加工サイスの敷細化が進んでいる。このリンラフィーブロセスにおいては、レジスト組成物を基板上に塗布し、船小投影器光装置(ステッパー)によってマス・パターンを移り、適当な原境で現像することによって、所望のパターンを得ている。しかしながら、このプロセスに用いられる反射体の高いアルミーウム、アルニウムーシリコン合金やアルミーウムーシリコン一網合金、ポリシリコン、タングステンシリサイド等の基板は、肥料した放射線を表面で反射してしまう。その影響で、レジストパターンにハレーションが生じ、晩野都

【0003】この問題を解決するため、基板上に形成す ペきレジスト膜の下に基板から反射した放射線を吸収す る性質のある反射防止膜を形成することが提案されてい る。このような反射防止膜としては、まず、直空蒸着、 CVD、スパッタリング等の方法により形成されるチタ ン膜、二酸化チタン膜、チッ化チタン膜、酸化クロム 膜、カーボン膜、またはαーシリコン膜等の無機膜が知 られているが、これらの無機系反射防止膜は、導電性を 有するため、集積回路の製造には使用できなかったり、 反射防止膜の形成に真空蒸着装置、CVD装置、スパッ タリング装置等の特別の装置を必要とする等の欠点があ った。この無機系反射防止膜の欠点を解決するために、 例えばポリアミド酸(共) 重合体またはポリスルホン (井) 重合体と染料からなる有機系反射防止膜が提案さ れている (例えば、特開昭59-93448号公報参 照)。この反射防止膜は、導電性が無く、また適当な溶 剤に溶解するので、特別の装置を必要としないで、レジ ストと同様に溶液状態で基板上に塗布できるものであ

[0004]

「発明が解決しようとする課間」しかしながら、ポリア 下酸(共) 重合体またはポリスルホン(共) 重合体と 染料からなる反射的止酸は、レジストとわずかながら混 じり合う(これは、インターミキシングと呼ばれる)が、 板け不食、報刊をといったレジストパターンがありため、 表化を招く等の問題がある。また、集積回路の機能化の 要来が減まるに伴い、レジストの一層の海底化が求める ないているが、上記を対抗止膜にカーラングされる遺産 (以下、エッチング速度という)が低いので、ドライエ サテングで下層反射的止膜を除去する工程において、長 時間のガスプラズマの照射を必要とするため、減度で 着されたレジスト層の表と同じに発食され、結果として レジスト層の表というながあるというながあると そこで本発明の目的は、前記従来の諸問題を影服し、反 射防止効果が高く、インターミキシングを生じることが なく、エッチング速度の高い、解像度及び精微等に優れ たレジストパターンを形成しうる反射防止膜形成組成 物、並びにレジストパターンの形成方法を提供すること にある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明の反射防止膜形成 組成物は、下記一般式(1)で示される構造単位および 下記一般式(2)で示される構造単位を有する共重合体 と、溶剤とを含有することを特徴とする反射防止膜形成 組成物。

[0006]

[化3]

$$R_2$$
 $CCCH_2$
 CO
 CH_2
 CH_2
 CH_2

(武中、R,は水素原子、ハロゲン原子、炭素原子数1 ~8の皮化水素施、ニトロ志、第1線アメニ とドロ・ キン基、アシル志、カルボキシル基、スルホン基また はメルカプト基を示し、R,が複数存在する場合にはそ れらは同一でも異なってもよく、R,は、水素原子また はメルカアル基を示し、mは1~9の整数を示す。) 【0007】

[化4]

$$\begin{array}{c} R_3 \\ \leftarrow C - CH_2 \\ \leftarrow CO \\ NH \\ CH_2 \\ OR. \end{array}$$

(式中、R₃は、水素原子またはメチル基を示し、R は、水素原子または有機基を示す。)

[0008]

共重合体

本発明の共重合体は、一般式(1) 【0009】

[4:5]

$$\begin{array}{c} R_2 \\ -(C-CH_2)-\\ CO \\ CH_2 \end{array} \tag{1}$$

(式中、 R_1 、 R_2 およびmは前記の通り) で表される構造単位を有する。

【0010】R.は、水素原子、ハロゲン原子、炭化水 素基、ニトロ基、第1級アミノ基、ヒドロキシ基、フェ ニル基、 アシル基、カルボキシル基、スルホン基また はメルカプト基を示す。炭化水素基としては、例えば、 炭素原子数1~6のアルキル基、アルケニル基およびア リール基が挙げられる。アルキル基としては、炭素原子 数1~6の直鎖状または炭素原子数3~6の分岐状アル キル基が好ましく、具体例としてメチル基、エチル基、 プロビル基、イソプロビル基、n-ブチル基、t-ブチ ル基等が挙げられる。アルケニル基としては炭素原子数 2~6のアルケニル基が好ましく、具体例としてビニル 基、プロペニル基、プテニル基等が挙げられる。ハロゲ ン原子としては、例えば、フッ素、 塩素、臭素を好ましい ものとして挙げることができる。またアシル基として は、炭素原子数1~6の脂肪族または芳香族アシル基を 好ましいものとして挙げることができ、具体的には、ホ ルミル基、アセチル基、フェナシル基等が挙げられる。 上記一般式 (1) で表される構造単位は、下記一般式 (3)

[0011] [化6]

$$R_2$$
 $C=CH_2$
 CO
 CH_2
 CH_2
 CH_2
 CH_2

(ここでR₁、R₂およびmも定額は上記一般式(1)と 同じである。)で表される アントラセン核含有(メタ) アクリル酸エステルモノマーに由来する。一般式(3)で 表されるアントラセン核含有(メタ)アクリル酸エステル は、例えば、式: 【0012】 【化7】

(式中、R、および小は前部の通り)で表されるアント ラセンメタノール化合物と(メタ)アクリル酸クロライド とを進基性化合物の存在下、有機溶剤中で反応すること により得られる。堪基性化合物としては、例えば、トリ エチルアミン、ピリジン等が挙げられ、有機溶媒として 使用することができ、好ましくは、プロピレンゲリコー ルモフアルキルエーテルが繋げられる。

【0013】一般式(3)のアントラセン核含有(メタ) アクリル酸エステルとしては、例えば、9ーアントラセ ンメタノール(メタ)アクリル酸エステル: 1ーメチルー 9-アントラセンメタノール(メタ)アクリル酸エステ ル、2-メチル-9-アントラセンメタノール(メタ)ア クリル酸エステル、1-エチル-9-アントラセンメタ ノール(メタ)アクリル酸エステル、2-エチル-9-ア ントラセンメタノール(メタ)アクリル酸エステル等のア ルキル置換9-アントラセンメタノール(メタ)アクリル 酸エステル類: 1 ークロロー 9 ーアントラセンメタノー ル(メタ)アクリル酸エステル、2-クロロー9-アント ラセンメタノール(メタ)アクリル酸エステル、1ープロ モー9-アントラセンメタノール(メタ)アクリル酸エス テル、2-ブロモー9-アントラセンメタノール(メタ) アクリル酸エステル等のハロゲン置換9ーアントラセン メタノール(メタ)アクリル酸エステル類:1-二トロー 9-アントラセンメタノール(メタ)アクリル酸エステ ル、2-ニトロー9ーアントラセンメタノール(メタ)ア クリル酸エステル等のニトロ置換9-アントラセンメタ ノール(メタ)アクリル酸エステル額:

【0014】1-アミノーの-アントラセンメタノール (メタ)アクリル酸エステル、2-アミノー9-アントラ センメタノール(メタ)アウリル酸エステル等のアミノ菌 接9-アントラセンメタノール(メタ)アクリル酸エステル ル類:1-ヒドロキシ-9-アントラセンメタノール (メタ)アクリル酸エステル、2-ヒドロキシー9-アントラセンメタノール(メタ)アクリル酸エステル、2-ヒドロキシー9-アントラセンメタノール(メタ)アクリル酸エステル類:1-アセチル-9-アントラセンメタノール(メタ)アクリル酸エステル類:1-アセチル-9-アントラセンメタノール(メタ)アクリル酸エステル病等が要がよりが、1-アローダーアントラセンメタノール(メタ)アクリル酸エステル病等が挙げられる。これのモイマーは、反射 防止膜の所望の特性に応じて、1種単独でまたは2種類 以上を混合して使用することができる。これらの化合物 のうち、9-アントラセンメタノール(メタ)アクリル酸 エステルが好ましく用いられる。本発明に用いられる共 重合の別の必須構造単位は、一般式(2) [0 0 15]

【0015】 【化8】

(式中、R₃およびR₄は前記の通り)で表されるもので ある。

【0016】尺法、火集原子あらいは有種基を示し、 特種基としては、たとえば、アルキル基等を挙げること ができる。アルキル基としては、炭集原子数1~6の直鎖 状または分岐状アルキル基が終ましいものとして挙げる ことができ、具体的にはメテル基、エチル基、プロビル 基、インプロビル基、ローブチル基、モーブチル基等を 例示することができる。上記一般式(2)で表される構 遺単位は、下記一般式(4)

[0017] [化9]

(ここでR,およびR,は前記の通り)で表される (メタ) アクリルアミド誘導体モノマーに由来する。該一般式 (4) で表される(メタ)アクリルアミド誘導体の内R₄ が水素原子であるものは、例えば、式:

[0018] [化10]

(ここでR,は前記の通り)で表される(メタ)アクリルア ミドとホルムアルデヒドおよび/またはパラホルムアル デヒドとを反応させることにより容易に得られる。R が前記の有機基であるものは、上記式で表わされる(メ g) アクリルアミドを R_a に相当する基を有するアルコール (即ち、 R_a O H) の存在下で、ホルムアルデヒド および/またはパラホルムアルデヒドとを反応させることによりにより得られる。

【0020】未発明に用いられる共奮合体は前記一般式 (1)の構造単位さまび一段で、2)の構造単位の他 に、持られる程成物の塗布性、得られる反射防止膜の耐 熱性等を改良する目的で、他の構造単位を含むことがで きる。このような性の構造単位としては、不整めま 合き有する単量体に由来する構造単位を挙げることがで きる。かかる他の構造単位はこのような単量体を前記一 般式 (3)の化合物および一般式 (4)の化合物とも に共奮的に供することにより、共重合体構造中に導入さ れる。

[0021] このような不能和単量体としては、例えば、ステレン、αーメギルステレン、0ーメチルステレン、0ービロキシステレン、0ービロキシステレン、0ービロキシステレン、0ービロキシステレン、0ービロキシステレン、0ービロキシステレン、0ーでロキシステレン、0ーでロキシステレン、0ーでロギンステレン、0ーでロジステレン、0ーでロジステレン、0ーでロジステレン等の置換ステレン系が合物:酢酸ビニル、カプロごオン酸ビニル等のシアン化ビニル化合のド・メテル(メタ)アクリロニトリル、αークロロアクリロニトリルド、タンアクリレート、エークロアのリレート、ローブロジル(メタ)アクリレート、0・プロジル(メタ)アクリレート、0・プロジル(メタ)アクリレート、0・プロジル(メタ)アクリレート、6・プロジル(メタ)アクリレート、6・プロジル(メタ)アクリレート、6・プロジル(メタ)アクリレート、6・プロジル(メタ)アクリレート、6・プロジル(メタ)アクリレート、6・プロジル(メタ)アクリレート。5・アクリンジル(メタ)アクリレート。9の不飽和カルボン酸エステル系化合物:

[0022] エチレングリコールジ (メタ) アクリレー
、プロピレングリコールジ (メタ) アクリレー
、グルビレングリコールジ (メタ) アクリレー
・ (メタ) アクリル酸ビニル、ジメチルビニルメタクリロ
イルオキシメチルシラン等の不悠和返告者不整和カル・クロ
の酢酸ビニル、クロロ酢酸アリル等のハロゲン含者ビニル系化合物: 2 ーとドロキシエチル (メタ) アクリレー
ト、2 ーとドロキシブロビル (メタ) アクリレート、N

ーメチロール (メタ) アクリルアミド、(メタ) アリル アルコール等の水酸基含有ビニル系化合物: (メタ) アリ クリルアミド、クロトン酸ドミド等のアミド基含有ビニ ル系化合物: 2 – メタウロイルオキンエチルコハク酸、 ニーメタウロイルオキシエチルロイン 酸等のカルボキ シル塩含有ビニル系化合物: 1 ービニルナフタレン、2 ービニルナフタレン、9 ービニルアントラセン、9 ービ ニルカルバゾール等のビニルアリール系化合物等が挙げ られる。これらの不飽和甲葉林は、1理単独でまたは2 種以上を握合して使用することができる。

[0023] 本発明で用いられる共置合体は、一般式 (1) および一般式 (2) で表される構造単位と、上配 助きその他の不免取単量体に由まる構造単位の合計を 基準にして、一般式 (1) の構造単位を5~90モル %。 好主しくは 10~80%。 更に好ましくは、20~ 80%合有する。一般式 (2) の構造単位は、5~80 モル%。 好ましくは、5~70モル%、更に好ましくは、10~60モル%合有される。その他の不飽和単量 体に由来の構造単位が存在する場合には、60モル%以 下含含される。

[0024] 本祭明の反射的上版を構成する共動合体 は、例えばラジカル型合、アニオン重合、カチオン重合 等の遺質の方法により、溶液重合等の重合形態で製造す ることができる。該共重合体のポリステレン機算重量平 均分子量(以下Mwという)は、反射的止暖の所質の特 性に応じて適宜製きされるが、通常2、000~10 00、000、好ましくは、3、000~700、00 0、特計好ましくは、5、000~500、000であ る。

【0025】溶剤

本発明の組成物を構成する溶剤としては、反射防止膜材 料を溶解しうる溶剤、例えばエチレングリコールモノメ チルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテ ル、エチレングリコールモノプロピルエーテル、エチレ ングリコールモノ ブチルエーテル等のエチレングリコー ルモノアルキルエーテル類:エチレングリコールモノメ チルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチ ルエーテルアセテート、エチレングリコールモノブロビ ルエーテルアセテート、エチレングリコールモノブチル エーテルアセテート等のエチレングリコールモノアルキ ルエーテルアセテート類;ジエチレングリコールジメチ ルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、 ジェチレングリコールジプロピルエーテル、ジェチレン グリコールジブチルエーテル等のジェチレングリコール ジアルキルエーテル類:プロピレングリコールモノメチ ルエーテル、プロビレングリコールモノエチルエーテ ル、プロビレングリコールモノプロビルエーテル、プロ ピレングリコールモノブチルエーテル等のプロピレング リコールモノアルキルエーテル額:

【0026】プロピレングリコールジメチルエーテル、

プロピレングリコールジエチルエーテル、プロピレングリコールジプロピルエーテル、プロピレングリコールジアルキルエーテル第: プロピレングリコールジアルキルエーテル第: プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノブチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノブラルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノアルエーテルアセテート第: 乳酸メチル、乳酸エチル、乳酸ロプロピル、乳酸インプロピル、乳酸インプロピル、乳酸インプロピル、乳酸インブロピル、乳酸インブロピル、乳酸ローブチル、乳酸ローイソブチル等:

【0027】ギ酸メチル、ギ酸エチル、ギ酸nープロピ ル、ギ酸イソプロピル、ギ酸n-ブチル、ギ酸イソブチ ル、ギ酸nーアミル、ギ酸イソアミル、酢酸メチル、酢 酸エチル、酢酸ブチル、酢酸n-アミル、酢酸イソアミ ル、酢酸 n ーヘキシル、プロピオン酸メチル、プロピオ ン酸エチル、プロピオン酸nープロピル、プロピオン酸 イソプロピル、プロピオン酸n-ブチル、プロピオン酸 イソプチル、酪酸メチル、酪酸エチル、酪酸nープロピ ル、酪酸イソプロビル、酪酸nーブチル、酪酸イソブチ ル等の脂肪族カルボン酸エステル類: ヒドロキシ酢酸エ チル、2-ヒドロキシ-2-メチルプロピオン酸エチ ル、3-メトキシ2-メチルプロピオン酸メチル、2-ヒドロキシー3-メチル酪酸メチル、メトキシ酢酸エチ ル、エトキシ酢酸エチル、3-メトキシブロピオン酸メ チル、3-エトキシプロピオン酸エチル、3-メトキシ プロピオン酸エチル、3ーメトキシブロピルアセテー ト、3ーメトキシブチルアセテート、3ーメチルー3ー メトキシブチルアセテート、3-メチル-3-メトキシ **ブチルプロピオネート、3ーメチルー3ーメトキシブチ** ルプチレート、アセト酢酸メチル、ビルビン酸メチル、 ピルビン酸エチル等の他のエステル類;

【0029】溶剤の配合量は、得られる組成物の固形分 濃度が0.01~70重量%程度、好ましくは0.05 ~60重量%、さらに好ましくは0.1~50重量%と なる範囲である。

以下である。

[0030] 他の成分

限り、必要に応じて各種巡加制を配合することができる。このような添加削としては、例えば、染料、界面等性無、硬化剤、酸煙生剤等を挙げることができる。 [0031] 前弦操料としては、例えば沸溶性染料、分散染料、塩高性染料、メテン系染料、ビラゾール系染料、ビラゾール系染料、ビラゾール系染料、ビラゾール系染料、ビラゾール系染料、ビラゾール系染料、ビラゾールの表質が、カマリン誘導体、ビージアミノステルベン、4、4、「・ジアミノステルベンは薄体、クマリン誘導体、ビラゾリン誘導体等の変光増白剤:ビドロキシアゾ系染料、チヌビン233(デ・バガイギー社製)、チヌビン234(デ・バガイギー社製)、チヌビン234(デ・バガイギー社製)、チヌビン254(デ・バガイギー社製)、チヌビン254(デ・バガイギー社製)をデ・ドルウェンが表導体、アントラセン誘導体、アントラセン誘導体、アントラセン誘導体、アントラセン誘導体、アントラキンが影響をいきが変がある。これらの型射線吸収性化合物の配合量は、反射防止膜が成相成物の固形分100重量的上り、対策としては、50至量節はア・野球としては、50至量節はア・野球としては、50至量節はア・野球としては、100至量節はア・野などしては、100至量節はア・野などしては、50至量節はア・野などしては、50至量節はア・野などは、100至量節はア・野などしては、100至量節はア・野などによりなどの変化を発展している。100至量節はア・野などによりなどの変化を発展している。100至単位はア・サービスを含むが、100至単位によりないる。100至単位はよりないる。100至単位によりないる。100至単位はよりないるなりないる。100至単位はなりないる。100至単位はなりないる。100至単位はなりはなりはなりないる。100至単位はなりはなりないる。100至単位はなりはなりなりを

本発明の組成物には、本発明の所望の効果を損なわない

【0032】前記界面活性剤は、塗布性、ストリエーシ ョン、ぬれ性、現像性等を改良する作用を有するもので ある。このような界面活性剤としては、例えばポリオキ シエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンステ アリルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテ ル、ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル、ポ リオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ポリエチレ ングリコールジラウレート、ポリエチレングリコールジ ステアレート等のノニオン系界面活性剤のほか、市販品 としては、例えばオルガノシロキサンポリマーである、 KP341 (商品名、信越化学工業製)、(メタ) アク リル酸系 (共) 重合体であるポリフローNo. 75、同No. 95 (商品名、共栄社油脂化学工業製)、エフトップEF10 1、同EF204、同EF303、同EF352 (商品名、トーケムプロ ダクツ製)、メガファックF171、同F172、同F173 (商品 名、大日本インキ化学工業製)、フロラードFC430、同F C431、同FC135、同FC93(商品名、住友スリーエム 製)、アサヒガードAG710、サーフロンS382、同SC101、 同SC102、同SC103、同SC104、同SC105、同SC106(商品 名、旭硝子製)等が挙げられる。これらの界面活性剤の 配合量は、反射防止膜組成物の固形分100重量部当た り、通常、15重量部以下、好ましくは、10重量部以 下である。

[0003] 前辺配た剤としては、例えば、トリレンジ イソシアナート、ジフェニルメタンジイソシアナート、 ヘキサメチレンジイソシアナート、短・エピュート81 メシアナート等のイソシアナート類:エピコート81 ス・同815、同826、同834、同83 6、同871、同1001、同1004、同1007、同1009、同1031、(商品名: 油作シェルエポキシ 製、アラルダイト6600、同6700、同6700、同6700、同 0、同502、同6071、同6084、同6097、 同6099(商品名:チバガイギー製)、DER331、 同332、同333、同661、同644、同667 (商品名:ゲウ製)等のエポキシ類:

[0034] サイメル300、同301、同303、同350、同370、同370、同371、同322、同322、同703、同712、同701、同272、同202、マイコート506、同508 (商品名:三井サイアナミッド製) 等のメラシ系硬化制・サイメル1123、同106、同130 (商品名:三井サイアナミッド製) 等のペンググアナミン系硬化制:サイメル1170、同1172 (商品名:三井サイアナミッド製)等のペンググアナミン系硬化剤:サイメル1170、同1172 (商品名:三井サイアナミッド製)等のペンググアナミン系域化剤:サイメル1170、同1172 (商品名:三井サイアナミンド製)等のペリコールウリル系硬化剤等が挙げられる。これらの要型のリコールウリル系硬化剤等が挙げられる。これらの重量が以下の30元を開発している。

【0035】前記酸発生剤としては光酸発生剤および熱 酸発生剤を使用することができる。光酸発生剤として は、例えばジフェニルヨードニウムトリフルオロメタン スルホネート、ジフェニルヨードニウムピレンスルホネ ート、ジフェニルヨードニウムドデシルベンゼンスルホ ネート、ジフェニルヨードニウムノナフルオロnーブタ ンスルホネート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨー ドニウムトリフルオロメタンスルホネート、ビス(4--t ープチルフェニル) ヨードニウムドデシルベンゼンス ルホネート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニ ウムナフタレンスルホネート、ピス(4―tープチルフ ェニル)ヨードニウムヘキサフルオロアンチモネート、 ピス (4-tーブチルフェニル) ヨードニウムノナフル オロnーブタンスルホネート、トリフェニルスルホニウ ムトリフルオロメタンスルホネート、トリフェニルスル ホニウムヘキサフルオロアンチモネート、

【0037】1ーナフチルジメチルスルホニウムトリフ ルオロメタンスルホネート、1ーナフチルジエチルスル ホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4ーシアノ ー1ーナフチルジメチルスルホニウムトリフルオロメタ ンスルホネート、4ーニトロー1ーナフテルジメチルス
ルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4ーメチ
タンスルホネート、4ージアノカルオニウムトリフルオロメ
タンスルホネート、4ーシアノー1ーナフチルージエチ
ルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4ー
トロー1ーナフチルジエチルスルホニウムトリフルオ
ロメタンスルホネート、4ーメチルー1ーナフチルジエ
チルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4
ービドロキシー1ーナフチルジメチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4ービドロキシー1ーナフチルジメチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4

【0038】4ーメトキシー1ーナフチルテトラヒドロ チオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-エトキシー1ーナフチルテトラヒドロチオフェニウムト リフルオロメタンスルホネート、4-メトキシメトキシ ー1ーナフチルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオ ロメタンスルホネート、4-エトキシメトキシー1-ナ フチルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタン スルホネート、4ー(1ーメトキシエトキシ)-1ーナ フチルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタン スルホネート、4-(2-メトキシエトキシ)-1-ナ フチルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタン スルホネート、4ーメトキシカルボニルオキシー1ーナ フチルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタン スルホネート、4ーエトキシカルボニルオキシー1ーナ フチルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタン スルホネート、4 - n - プロポキシカルボニルオキシー 1ーナフチルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオロ メタンスルホネート、

【0039】4-1-プロポキシカルボニルオキシー1 ーナフチルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメ タンスルホネート、4-n-プトキシカルボニルオキシ ー1ーナフチルテトラヒドロチオフェニウムトリフルオ ロメタンスルホネート、4ーtーブトキシカルボニルオ キシー 1 ーナフチルテトラヒドロチオフェニウムトリフ ルオロメタンスルホネート、4-(2-テトラヒドロフ ラニルオキシ) - 1 - ナフチルテトラヒドロチオフェニ ウムトリフルオロメタンスルホネート、4ー(2ーテト ラヒドロピラニルオキシ) ー 1 ーナフチルテトラヒドロ チオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-ベンジルオキシー 1ーナフチルテトラヒドロチオフェニ ウムトリフルオロメタンスルホネート、1-(ナフチル アセトメチル) テトラヒドロチオフェニウムトリフルオ ロメタンスルホネート等のオニウム塩系光酸発生剤類: フェニルーピス (トリクロロメチル) ーェートリアジ ートリアジン、ナフチルーピス (トリクロロメチル) ー

sートリアジン等のハロゲン含有化合物系光酸発生剤

7

符:

【0040】1、2ーナフトキノンジアジドー4ースル ホニルクロリド、1、2ーナフトキノンジアジドー5ー スルホニルクロリド、2、3、4、4'ーテトラベンゾ フェノンの1、2ーナフトキノンジアジドー4ースルホ ン酸エステルまたは 1.2 ーナフトキノンジアジドー5 スルホン酸エステル等のジアゾケトン化合物系光酸発 生剤類:4ートリスフェナシルスルホン、メシチルフェ ナシルスルホン、ピス(フェニルスルホニル)メタン、 ベンゾイントシレート、ピロガロールのトリストリフル オロメタンスルホネート、ニトロベンジルー9、10-ジェトキシアントラセンー2ースルホネート、トリフル オロメタンスルホニルビシクロ[2, 2, 1] ヘプトー 5-エン-2, 3-ジカルポジイミド、N-ヒドロキシ スクシンイミドトリフルオロメタンスルホネート、1. 8 ーナフタレンジカルボン酸イミドトリフルオロメタン スルホネート等のスルホン酸化合物系光酸発生剤類等が 挙げられる.

[0041] 前記機能発生剤としては、例えば2、4、4、6ーテトラブロモシクロヘキサー3、5ージエ/ン、ベンゾイントシレート、2ーニトロペンジルトシレート、アルキルスルホネート等が挙げられる。これらの 飲売生剤の配合量は、反射放止膜細成物の固形分100 重量部出たり、通常、5000重量部以下、好ましくは、0、1重量部以上1000重量部以下である。さらにその他の添加剤として保存安定剤、消泡剤、接着助剤等を挙げることもできる。

【0042】組成物の使用法

本発明の組成物は、パターン化したレジスト版の形成に いて、例えば、次のように使用される、即ち、パター ン化したレジスト版の形成方法は、1) 基板上に反射防 止膜原原起成物を塗布し、しかる後ペークして反射防止 機を形成する工程。2) 版反射抗速度にレジスト版を形成する 工程。3) レジスト版に需必用マスクを介して放射線を 無割する工程、4) 放射線を開射したレジスト版を現な する工程、及び5) 反射防止膜をエッチングする工程を 含む。

【0043】具体的には、レジストパターンの形成方法 は、まず、基板上に反射防止膜形熔相成物を所定の膜 原、例えば100~5000カングストロームとなるように、回転差布、返延差布ロール差布等の方法により軽 市する。次いで、ベークして反射は異相核物を対しまりを で程度である。前記のようにして基板上に反射防止膜を形成したのち、第22程で、設皮材防止膜上に得られるレジスト膜が所定の関係となるように差布し、ブレベーク レてレジスト膜中の溶剤を揮発させて、レジスト膜を形成の原体が変化が変化が変化が変化が変化がある。 が表していたので発性を表して、プレベーク 成する。この際のブレベークの温度は、使用されるレジストの便勝等に応じて適宜関数されるが、透常、30~ 20~10程度、非社(は、50~150~250~36~36~ 【0044】レジスト版を形成する際には、レジストを 動当な溶液中に、固形分遺版が例えばって、50重量%と なるように溶解したのち、例えば孔径の、2μ相程度の フィルターでみ退して、溶液を調製し、これを、回転率 布、波延整布、ロール準布等の方法により、例えばシリ コンウエハー、アルミニウムで被覆したウエハー等の基 板の反射防止機上に坐布する。なお、この場合、市販の 板の反射防止機上に坐布する。なお、元の場合、市販の がストパターンの形成に使用さる。 木発明におけるレ ジストパターンの形成に使用されるレジストとしては、 例えばアルカリ可溶性関節とキノンジアジド系形が気 線性実権剤とからなるボジ型レジスト、アルカリ可溶性関節と対数 線性実権剤とからなるボジ型よたはよガ型の化学増幅型レジスト 非常を単常したとができる。

[0045] その後、第3二程で、レジスト限に電光用 マスクを介して放射線を照射する(以下「電光」とい う)。レジストの種類に応じて、可視火線、海外線、遠 紫外線、X線、電子線、下線、分子線、イオンピーム等 の適当な放射線と、用いることができる。これらの放射 線のうち、好ましいのは、遠紫外線であり、特に、KF エキシマレーザー (24 mm) 及びAFエキシマレー ザー (193 nm) が本願の相談的には労運に用いられ

9- [0046]次いで第4工程で、これを現像する。その 後洗浄し、乾燥することにより、所望のレジストパター 少を形成する。この工程中、飛旋度、パターン部状、現 像性等を向上させるため、裏光後、現像前にペーキング を行ってもよい、最後に第5工程で、レジストパターン をマスクとして、膨素プラスマを行い、基板加工用のレ ジストパターンを報る。

[0047] 未発別におけるレジストパターンの制成に 使用される現像決としては、例えば水酸化ナトリウム、 水酸化カリウム、皮酸トトリウム、 建酸ナトリウム、メ タ珪酸ナトリウム、アンモニア、エチルアミン、ロープ ロピルアミン、ジェチルアミン、メーロープロピルアミ ン、トリエチルアミン、メチルジエチルアミン、ジメチ ルエタノールアミン、トリユタノールアミン、テトラメ チルアンセニーウムとドロキシド、テトラエチルアンモニ ウムヒドロキシド、ピロール、ピペリシン、コリン、

1、B - ジアザビシクロ(5、4、0) - フーウンデセ ン、1、5 - ジアザビシクロー(4、3、0) - 5 - ノ ナン等を溶解したアルカリセ水溶液を挙げることができ る。また、これらの現像凍には、水溶性有機溶解、例え ばメタノール、エタノール等のアルコール類、および界 面活性熱を適量筋加することもできる。

[0048]

【実施例】以下、実施例を挙げて本発明を更に具体的に 説明する。ただし、本発明はこれらの実施例に何ら制約 されるものではない。以下の説明において「部」は特配 しない限り「重量部」を意味する。以下の実施例及び比較例で使用したレジストは、KrF用ポジ型レジスト (商品名KrF K2G、ジェイエスアール(株)製) である。反射防止膜形成組成物の性能評価は、下記の要 領で行った。

【0049】 (り乗性: 直径4インチのシリコンウエハーの表面に反射防止膜形成組成物をスピンコートしたのち、ホットブレート上で90で1分間ペークして関厚
0.1 μmの反射防止膜を形成した。次に、この反射防 止膜を形成したシリコンウエハーの上方に1cmの間底 を置いて平行に別の同寸法のシリコンウエハーを配置した。この状態で、一枚目の反射防止膜を形成したシリコンウエハーを配置した。との状態で、一枚目の反射防止膜を形成したシリコンウエハーを200で2分間さらにペークした。その 後、上方に配置したシリコンウエハーの下側の表面に一枚目のウエハーからの昇帯物が凝縮して付着しているか 否か目視により関へた。繊維物の付張の有端により、反射防止膜形成組成物。の昇来性を押した。

【0050】〇解像度:4インチのシリコンウエハー上 に、反射防止膜形成組成物をスピンコートしたのち、ホ ットプレート上で90℃で1分間、200℃で2分間べ -クして膜厚0、 1μ mの反射防止膜を形成した。その 後、該反射防止膜上にレジストを膜厚 0. 7μmのレジ スト膜が得られるようにスピンコートしたのち、80℃ のホットプレート上で2分間ベークし、レジスト膜を形 成した。次いで、ホールパターンの中央部に(株)ニコ ン製ステッパ-NSR2005EX8A (波長248nm) を用いて、 5 μ m幅のラインアンドスペースパターンを1対1 の線幅で形成する露光時間(以下「最適露光時間」とい う。) だけ露光を行った。次いで、100°Cのホットプ レート上で、2分間ペーキングを行ったのち、2.38 重量%テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液を 用い、25℃で1分間現像し、水洗し、乾燥して、レジ ストパターンを形成した。解像された最小線幅のレジス トパターンの寸法を、走査型電子顕微鏡を用いて測定し t=~

【0051】〇インターミキシング防止効果・前記解金 皮の評価の場合と同様にして、反射防止膜およびレジス ト膜の形成、露光並びに現像を行った。レジスト膜の現 像により除去された部分の、反射防止膜との接点におけ るレジスト膜の報引きの程度を走査型電子顕微鏡を用い で調べた。

○定在波防止効果:前証解像度の評価の場合と同様にして、反射防止膜およびレジスト膜の形成、露光並びに現 候を行った。その後、レジスト膜への定在波の影響の有 無を走査型電子顕微鏡を用いて調べた。

○エッチング速度:前記解像度の評価の場合と同様にして、反射防止膜およびレジスト膜の形成、露光並びに現像を行った。その後、酸素プライエッチング (圧力16Pa、Ff電力300所、エッチング対ス 酸素)がを行い、反射防止膜のエッチング速度を測定し、反射防止

止膜とレジスト膜とのエッチング速度比(反射防止膜の エッチング速度/レジスト膜のエッチング速度)を求め た。

【0052】合成例1(モノマーの合成)

温度財任機力たセパラブルフラスコに、9 ーアントラセンメタノール80部、トリエチルアミン55部、およびプロビレングリコールモノメチルエーテル500部を放 え、10°以下に冷却し、塩化メタクリロイル58部を徐々に流下し、10°以下で20時間機斧した。その後、フラスコの内容物を水中に投入し、1000部の静エチルを加えて輸出を行ったのち、溶解を減圧除去した。こうして得られた関体を、nーヘキントルエン(2:1)中で再結晶し、下近の化学構造式で売される9一アントラセンメタノールメタクリル酸エステルモノマーを得た。

[0053]

【0054】 筆合例 1

温度計および冷却管を備えたセパラブルフラスコに、合 成例1で得られたモノマー20部、ヒドロキシエチルメ タクリレート9. 4部、N-(ヒドロキシメチル)アク リルアミド2部、アゾビスイソプチロニトリル0.6部 およびプロビレングリコールモノメチルエーテル500 部を加え、窒素パブリングしながら80℃で8時間攪拌 した。その後、フラスコ内容物を水中に投入し、析出し た樹脂を真空乾燥器にて40℃で一晩乾燥した。得られ た樹脂のポリスチレン換算の重量平均分子量Mwをゲル パーミエーションクロマトグラフィーで測定したとこ ろ、10、000であった。また、赤外線吸収スペクト ルを測定したところ、図1に示す結果が得られた。さら に、'H-NMRの測定を行ったところ、図2に示す下 記の結果が得られた。以上の結果から、9ーアントラセ ンメタノールメタクリル酸エステル、ヒドロキシエチル メタクリレートおよびNー (ヒドロキシメチル) アクリ **ルアミドが4:4:1 (モル比) で共重合した、下記構** 造を有する共重合体であることが確認された。

[(t.12]

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} CH_{3} \\ C-CH_{2} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_{2} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_{$$

[式中、x、yおよびzはそれぞれそれらが付された構 造単位の数を示す自然数であり、×:y:z=4:4: 1である。]

【0055】重合例2

重合例1におけるヒドロキシエチルメタクリレート9. 4部の代りにメタクリル酸6.2部を使用した以外は、 重合例 1 と同様にして、Mw 1 0、000 (ポリスチレ ン換算)の樹脂を得た。1H-NMRの結果から、9-アントラセンメタノールメタクリル酸エステル、メタク リル酸およびNー (ヒドロキシメチル) アクリルアミド が4:4:1 (モル比) で共重合した構造であることが 確認された。

【0056】 重合例3

温度計および冷却管を備えたセパラブルフラスコに、合 成例1で得られたモノマー50部、ヒドロキシエチルメ

タクリレート9. 4部、アセナフチレン5. 5部、N-(ヒドロキシメチル) アクリルアミド7. 3部、アゾビ スイソプチロニトリル 1. 4 部およびプロピレングリコ ールモノメチルエーテル500部を加え、窒素パブリン グしながら80℃で8時間機拌した。その後、フラスコ 内容物を水中に投入し、析出した樹脂を真空乾燥器にて 40°Cで一晩乾燥した。得られた樹脂は、Mw1500 O (ポリスチレン換算)で、1H-NMRの結果から、 9ーアントラセンメタノールメタクリル酸エステル、ヒ ドロキシエチルメタクリレート、アセナフチレンおよび N- (ヒドロキシメチル) アクリルアミドが、5:2: 1:2(モル比)で共重合した構造であることが確認さ

【0057】実施例1~3

重合例1~3で得られた各樹脂を用いて、以下のように して3種の反射防止膜形成組成物を調製した。樹脂5部 およびピス(4-t-ブチルフェニル)ヨードニウムカンファ ースルホネート0.5部を、乳酸エチル90部に溶解 し、孔径 O. 2 μ mのメンブランフィルターでろ過し、 組成物を調製した。次いで、得られた各組成物につい て、前記のようにしてレジストパターンの形成および反 射防止膜の性能評価を行った。評価結果を表1に示す。 [0058]

【表 1】

	昇華性	解像度	インターミキシンク	定在波	エッチング速度比
		(μm)	防止効果	防止効果	
実施例1	無し	0. 22	裾引き無し	定在波無し	3.0以上
実施例2	無し	0. 22	裾引き無し	定在波無し	3.0以上
実施例3	無し	0. 22	裾引き無し	定在波無し	3.0以上

[0059]

【発明の効果】本発明の反射防止膜形成組成物は、反射 防止効果が高く、レジストとインターミキシングを生じ ることが無く、エッチング速度が大きく、しかもポジ型 およびネガ型レジストと協働して、解像度、精度等に優 れたレジストパターンをもたらすことができる反射防止 膜を形成することができる。したがって、この組成物

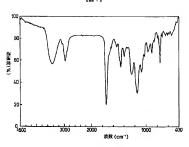
は、特に高集積度の集積回路の製造に寄与するところが 大である。

【図面の簡単な説明】

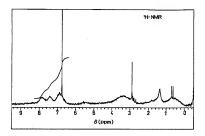
【図1】図1は重合例1で得られた共重合体の赤外線吸 収スペクトルを示す。

【図2】図2は筆合例1で得られた共重合体の H-N MRスペクトルを示す。





[図2]



フロントページの続き

(51) Int. CI. ⁷ 機別配号 FI デーマコード(参考) G O 3 F 7/027 5 1 4 G O 3 F 7/027 5 1 4 H O 1 L 21/027 H O 1 L 21/30 5 7 4

(72)発明者 岩永 伸一郎

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ エスアール株式会社内 Fターム(参考) 2H025 AA00 AA02 AB16 AC01 AC04 AC08 AD01 AD03 DA34 FA03

FA12 FA17 FA41

4J002 BC011 BF011 BG041 BG051 BG071 BG101 BG131 BH001

FD150 FD206 GH01 GP03

4J100 AL08P AM41Q BA03P BA03Q

BA04Q BA05Q BA06Q BA14P

BA16P BA29P BA41P BA52P

BASSP BB01P BB03P BC48P

CA04 JA38

5F046 PA07